

Bericht der Regionalgruppenveranstaltung der Regionalgruppe Stuttgart bei der Eltroplan GmbH in Endingen am 07.07.2010.:

Perfektion am Kaiserstuhl: FED Regionalgruppentreffen bei Eltroplan

25 Teilnehmer aus Baden-Württemberg trafen sich zur FED-Regionalgruppensitzung bei der Firma Eltroplan GmbH in Endingen. Zwei Fachvorträge und eine Betriebsführung begeisterten die Teilnehmer.



Regionalgruppenleiter Oliver Riese bei der Begrüßung der Gäste

„Ich freue mich, dass die Mitgliederzahl des FED auch während der Krise gestiegen ist. Dies zeigt mir, dass Verbandsarbeit gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist,“ so begrüßte der Regionalgruppenleiter Oliver Riese die 25 Teilnehmer des Regionalgruppentreffens der Regionalgruppe Stuttgart besuchten 25 Entwickler und Leiterplattenlayouter besuchten hierfür das Endinger Unternehmen Eltroplan GmbH um sich über neue Technologien und Kriterien für gutes Leiterplattendesign zu informieren. Neben dem Gastgeber

Eltroplan, Herr Michael Pawellek und dem Regionalgruppenleiter Oliver Riese, referierten zwei weitere Firmen, Herr Conrad von der Würth Elektronik GmbH & Co. KG sowie Herr Detlef Rieck von der GEDmbh. Themenschwerpunkte waren Embedded Components sowie EMV gerechtes Leiterplattendesign.

Nachdem sich die Teilnehmer beim einem kleinen Come Together gestärkt hatten, begrüßte Herr Oliver Riese von der riese electronic gmbh im Namen des FED die zahlreichen Teilnehmer und stellte den Verband kurz vor. Dabei wies er auch auf die kommende FED Konferenz in Fellbach hin.

Im Anschluss daran hatte der Gastgeber Herr Michael Pawellek von Eltroplan GmbH das Wort. „Die Eltroplan GmbH ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit außergewöhnlichen Technologien und spezialisiert sich ganz bewusst auf Nischenprodukte und bietet ein rundes Gesamtpaket an“

Er erklärte die Kernkompetenzen der Eltroplan GmbH und ging auf die Firmenhistorie sowie die Firmenphilosophie ein.

Herr Klaus Dingler übernahm das Wort und referierte über Neuigkeiten aus der FED Geschäftsstelle, wie z.B. neu übersetzte Normen.



FED Regionalgruppenleiter Oliver Riese und Geschäftsführer der Eltroplan GmbH, Michael Pawellek (v.L.)



Detlef Rieck von der GEDmbh referiert über die Voraussetzungen für EMV-gerechtes Leiterplattendesign



Herr Conrad, Würth Elektronik zum Thema Embedded Components



Die Teilnehmer lauschen den interessanten Vorträgen

Nach den begrüßenden Worten stieg man gleich tief in die Technik ein. Embedded Components, der Herstellungsprozess und die Anforderungen an das Leiterplattendesign dieser Zukunftstechnologie, bei der die Bauteile in die Leiterplatte integriert sind, war Thema des ersten Vortrags gehalten von Herrn Conrad, Würth Elektronik GmbH & Co. KG. Conrad stellte in diesem Zusammenhang das neue, patentierte Lasercavity-Verfahren vor. „Wir werden kleiner, kompakter und sicherer“, so Conrad. Mit diesem Verfahren hat Würth eine Technologie entwickelt, die es erlaubt, aktive Flip-Chip-Bauelemente in die Leiterplatte zu integrieren. Er zeigte Möglichkeiten und Anwendungsbereiche aus der Praxis.

Im Anschluss daran erläuterte Detlef Rieck von der GEDmbh die Voraussetzungen für EMV-gerechtes Leiterplattendesign. Kurze Leiterbahnen, impedanzkontrollierte Signalleiterbahnen, sowie eine induktivitätsarme Stromversorgung sind laut Rieck unbedingt zu beachten. Werden Multilayer designed, so ist zusätzlich auf einen kleinen Abstand zwischen den GND- und VCC-Lagen zu achten. „Besonders wichtig ist, dass Entwickler und Layouter schon zu Beginn der Entwicklung eng zusammenarbeiten“, stellte Rieck fest.

Bei dem anschließenden Betriebsrundgang erhielten die Teilnehmer einen Einblick in die Fertigung und die Technologien der Firma Eltroplan. Hier bekamen die Teilnehmer in der Praxis mit, mit welchen außergewöhnlichen Themen sich die Eltroplan GmbH beschäftigt.